

AN-1295 应用笔记

One Technology Way • P.O. Box 9106 • Norwood, MA 02062-9106, U.S.A. • Tel: 781.329.4700 • Fax: 781.461.3113 • www.analog.com

ADIS16375、ADIS16480、ADIS16485和ADIS16488的机械设计技巧

作者: Mark Looney

封装特性

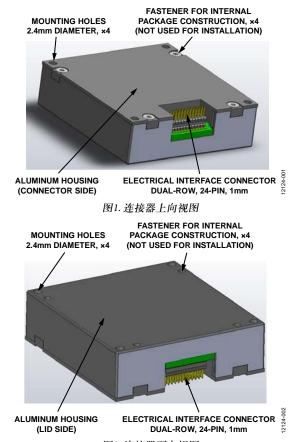
ADIS16375、ADIS16480、ADIS16485和ADIS16488的封装特性包括: 2.4 mm直径安装孔、铝质外壳和双排、24引脚、1 mm间距电气接口连接器。图1显示封装的连接器端。在该视图中,连接器引脚朝上,可以看见四个安装孔和四个螺丝头。四个机械螺丝头是内部封装的一部分,不包括在系统级安装过程中。图2显示封装的金属盖。在该视图中,可以看到有8个孔,其中4个可在系统级安装过程中使用。

封装基础知识

机械灵敏度

ADIS16375、ADIS16480、ADIS16485和ADIS16488的封装支持上向连接器和下向连接器安装方式。下向安装表示对接连接器和安装面在同一表面上。上向安装表示对接连接器和安装面不在同一表面上。除了连接器的朝向外,还应遵循下列三条准则以获得最佳性能。

- 1. 仅在四个角上施加安装力。
- 2. 避免对连接器施加残余的平移应力。
- 3. 对安装螺丝施加40英寸-盎司的扭矩。



AN-1295

安装孔位置

根据封装图中的基本尺寸选择安装孔的位置。图3显示封装的简化视图,并突出显示了基本尺寸安装孔直径必须要能让安装螺丝通过。为了实现这一目的,请考虑下列可能产生误差的情况:

- 1. 惯性测量单元(IMU)封装的安装孔直径(最大2.4 mm)
- 2. 电气连接器相对于IMU封装上的安装孔中心位置的位置 容差(最大±0.3 mm)
- 3. 电气连接器相对于对接面上的安装孔中心位置的位置容差 虽然每个系统对这三个误差项的贡献各有不同,但下式可 说明如何调和误差贡献;假定它为±0.3 mm;

$$2.4mm + \sqrt{(0.3mm)^2 + (0.3mm)^2} = 2.85mm$$

请记住,主要目的是为了保护连接器在连接后不受到平移 应力的影响,因此请务必评估所有可能造成安装孔和对接 连接器之间产生位置误差的因素。

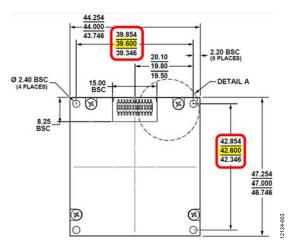


图3. 外形尺寸,包括安装孔之间的尺寸

安装示例

安装示例1: 下向安装在垫圈上

图4和图5显示第一个示例,对接连接器位于系统印刷电路板(PCB)的安装面。IMU放在四个垫圈上,使IMU主体远离PCB表面,从而安装力聚集在封装的四角。此外,该方法在PCB的背面使用垫圈和螺母。IMU和PCB表面之间的垫圈必须足够厚,确保IMU主体的任何位置都不与安装面相接触,而只接触垫圈。虽然0.25 mm厚的垫圈考虑到了不同的封装平坦度,但没有考虑到PCB表面的不同平坦度,因此最终值可能大于0.25 mm。

此外,为了防止封装主体接触PCB,应确保对接连接器与IMU的电气连接器相对接时不会触底,因为这会增加安装时受力不均的可能性。SAMTEC的CLM-11-02系列具有足够的间隙,避免触底。SAMTEC的MLE-112-02系列具有较大的对接覆盖面积,但可能需要额外抬高IMU。无论对接连接器解决方案如何,请不要让连接器的基座互相接触,因为这样可能会产生残余力。

由于单独的机械容差相叠加,在PCB上使用螺孔来安装 IMU可能会对电气连接器产生平移应力。完成IMU在PCB 上的安装后,确保其余任何装配操作都不会对IMU连接器 产生机械应力。

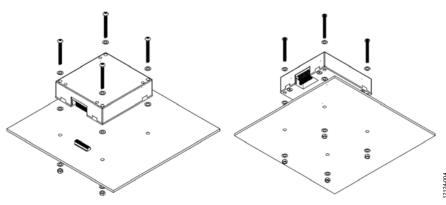


图4. 安装示例1, 概述

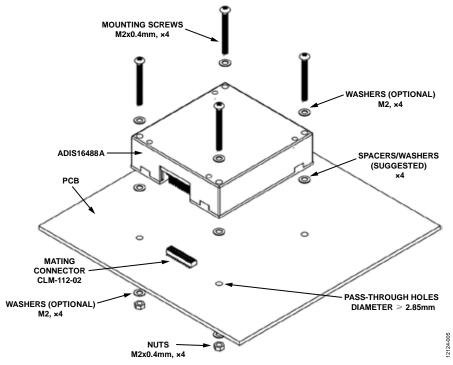


图5. 安装示例1, 重要组件和属性

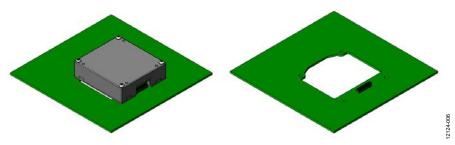


图6. 带挖空区域的PCB, 安装/未安装器件

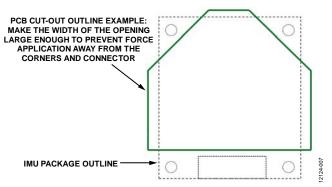


图7. PCB挖空尺寸示例和IMU封装尺寸

AN-1295

安装示例2:下向安装在挖空PCB上

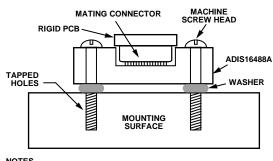
图6和图7显示了第二个示例。该示例使用了挖空PCB,这样无需垫圈支撑封装远离PCB表面就能聚集封装四个角的安装力。挖空的形状取决于多种因素,包括PCB厚度和PCB设计制造规则。

图7提供了示例PCB挖空区域的顶视图。挖空的几何尺寸是 灵活变化的,每种情形下都需要特别留意。最重要的考虑 因素是聚集安装力,使其远离IMU主体的中心位置。图7 中的挖空区域实际上要大于IMU封装面积,就是为了实现 这一目标。

安装示例3:上向安装,Flex电缆接口

图8显示的是第三个示例,在该示例中连接器背对着安装面,且IMU放在四个垫圈上,使IMU主体远离安装面。

IMU和PCB表面之间的垫圈必须足够厚,确保IMU主体的任何位置都不与安装面相接触,而只接触垫圈。虽然0.25 mm厚的垫圈考虑到了不同的封装平坦度,但没有考虑到PCB表面的不同平坦度,因此最终值可能大于0.25 mm。

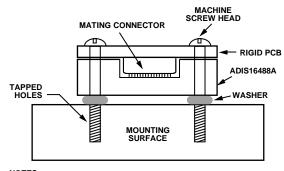


NOTES
1. MACHINE SCREWS WILL NOT BE VISIBLE CROSS SECTION
VIEW FOR ILLUSTRATION PURPOSES ONLY.

图8. 安装示例3,图示

安装示例4: 上向安装, Flex电缆连接硬件

图9显示的是第四个示例。在该示例中,连接器依然背对着安装面,但采用了严格对接的连接器接口,利用安装硬件将连接固定在位置上。与第三个示例相同,IMU放在四个垫圈上,使IMU主体远离安装面。本例与第三个安装示例的特性相同,但不同的是其对接连接器严格安装在基板上。



NOTES
1. MACHINE SCREWS WILL NOT BE VISIBLE CROSS SECTION VIEW FOR ILLUSTRATION PURPOSES ONLY.

图9. 安装示例4, 图示

修订历史

2014年2月—修订版0: 初始版

